

インスペック株式会社



世界最速レベルの半導体 パッケージ外観検査装置

秋田県
仙北市角館町雲然荒屋敷79-1

1988年(昭和63年)設立
TEL 0187-54-1888

<http://www.inspec21.com>

代表取締役
菅原 雅史

独自の高分解像度画像処理エンジンの開発により、業界初となる 8000bit のライン CCD カメラを搭載した半導体パッケージ外観検査装置を商品化。

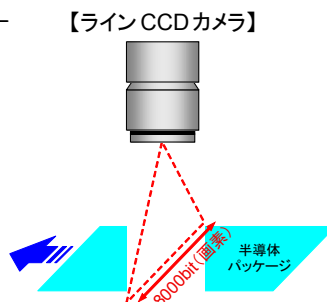
半導体パッケージの全数検査に威力を発揮する高性能画像処理技術

デジタル関連機器の性能を決定づける半導体パッケージは、高密度化が進む中で品質保証もより高い質が求められており、抜き取り検査から全数検査への移行とともに、目視や顕微鏡等による検査から、高性能画像処理技術を取り入れた検査に変わりつつある。

世界トップレベルにある高分解像度画像処理エンジン

インスペック株式会社は、1990年代の半ばから画像処理による半導体パッケージ外観検査装置の開発に取り組み、2002年に業界初の8,000bit(画素)のラインCCD(電荷結合素子)カメラ*を採用した高分解像度画像処理エンジン「inspec2」を開発。2004年には「inspec2」を搭載した世界最速レベルの外観検査装置(6,400万画素の画像処理能力0.2秒)の商品化に成功し、大手半導体関連メーカーからも高く評価されている。

* ライン(1次元)センサーは、受光する感光部が1列に配置されたセンサーで、FAX、コピー、スキャナー、バーコードリーダーなどに用いられており、汎用用途の撮像に使用できるようにしたものがラインCCDカメラ(右図参照)。



リードフレーム外観検査装置



テープCSP外観検査装置

次世代画像処理エンジンの開発

インスペック株式会社の強みは、長年の製品開発で培った高度なノウハウの蓄積にあり、高分解像度画像処理エンジンの開発に不可欠な基本技術は全て自社保有している。現在は、次世代画像処理エンジン「inspec3」を搭載する新型外観検査装置(検査速度・性能で10倍の能力)を開発中。



P-BGA・P-CSP外観検査装置



ウェハー検査装置